



Klebstoffe & Gießharze

Als weltweit führender Hersteller von „Circuit Assembly Materials“ (Material für die Leiterplatten-Bestückung) bietet Henkel bewährte, innovative Technologien.

In Form von Pasten und Folien werden die besten Klebstoffe, Gießharze, Chipabdeckungs- und Schutzlackmaterialien geboten, welche über Jahrzehnte hinweg entwickelt wurden.

Die Produktbereiche basieren auf den Technologien der Epoxid-, Silikon- und Polyurethanharze und schließen lichterhärtende Produkte ein. Dazu gehören sowohl elektrisch und thermisch leitende, als auch isolierende Materialien.

Materialien für die Leiterplattenbestückung:

Mit den neuen Klebstoffen von Henkel ist nun endlich eine wirklich einfach zu verwendende Polymer-Alternative zum Löten gegeben.

Diese schnell härtenden Klebstoffe ersetzen Lötzinn und erfüllen dabei alle Anforderungen hinsichtlich thermischer, elektrischer und mechanischer Eigenschaften, ohne dabei die mit Blei verbundenen Nachteile aufzuweisen. Die Produkte können problemlos bei den meisten Oberflächenmontage-Prozessen eingesetzt werden. Die Stress absorbierenden Klebstoffe verfügen über eine günstige Dot-Klebstoff-Geometrie und können mittels Schablonen- oder Siebdruck bzw. mit Dispensern aufgetragen werden.



- ✓ Anwendungen, bei denen elektrische Leitfähigkeit und niedrige Aushärtetemperaturen erforderlich sind
- ✓ Montage und Verbinden von Bauelementen in der SMD-Technik auf starren Substraten
- ✓ Montage von Bauteilen auf Keramik
- ✓ Aufbau von Schaltkreisen und Montage von Komponenten auf flexiblen Substraten
- ✓ Anwendungen bei denen eine hohe Wärmeleitfähigkeit erforderlich ist

Elektrisch leitfähige Materialien - Kleben statt Löten

Standardprodukte*

Produkt	Auftragung	Eignung	Chemie		Viskosität bei 25 °C, Pa*s	Aushärtung	Service-temperatur in °C
ECCOBOND CE 3103 WLV	Dispensen	Sn oder SnPb	Epoxy/Ag	1k	15 bis 25	3 min. bei 150 °C oder 10 min. bei 120 °C	-45 bis +150
ECCOBOND 84-1LMI	Dispensen / Drucken	Au	Epoxy/Ag	1k	28	120 min. bei 125 °C oder 60 min. bei 150 °C	bis +150
ECCOBOND CE 8500	Dispensen	Div. Oberflächen	Epoxy/Ag	1k	120 bis 140	90 min. bei 120 °C oder 15 min. bei 175 °C	-45 bis +200
ECCOBOND 56C mit CAT 9	Dispensen	Metall, Glas, Keramik, Kunststoff	Epoxy/Ag	2k	Pastös	2 Std. bei 50 °C	-60 bis +120
Loctite 3880	Dispensen	Div. Oberflächen	Epoxy/Ag	1k	50 bis 150	10 min. bei 125 °C oder 3 min. bei 175 °C	k. A.
Loctite 3888	Dispensen / Drucken	Div. Oberflächen	Epoxy/Ag	2k	Pastös	24 bis 48 Std. bei RT	-40 bis +80
Loctite 5421	Dispensen	Div. Oberflächen	Silikon	1k	Pastös	24 Std. bei RT	-40 bis +200

* Die hier angegebenen Messwerte der verschiedenen Eigenschaften basieren auf Messungen nach Normmethode und dürfen nicht für die Erstellung eigener Spezifikationen herangezogen werden. Hierzu müssen Messwerte durch eigene Messungen bestimmt und bestätigt werden.

Ihr Lieferant:

T-E-Klebertechnik

Anwendungs-, Verfahrens- und Dosiertechnik

Großer Kolonnenweg 3
Tel.: 0511 - 353982 - 0
Internet: www.t-e-klebertechnik.de

30163 Hannover
Fax.: 0511 353982 - 40
mail: infotek@t-e-klebertechnik.de

